

Rockchip RK3326 Linux SDK 快速入门

文件标识: RK-JC-YF-943

发布版本: V1.8.1

日期: 2022-09-20

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍 Rockchip RK3326 Linux SDK 的基本使用方法，旨在帮助开发者快速了解并使用 RK3326 Linux SDK 开发包。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot
RK3326/RK3326-S	Y

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	WJL	2022-06-16	初始版本
V1.8.0	WJL	2022-06-16	版本同步至 V1.8.0
V1.8.1	LinJianHua	2022-09-20	支持Linux5.10 SDK

目录

Rockchip RK3326 Linux SDK 快速入门

1. 开发环境搭建
2. 软件开发指南
 - 2.1 开发向导
 - 2.2 软件更新记录
3. 硬件开发指南
4. SDK 配置框架说明
 - 4.1 SDK 工程目录介绍
 - 4.2 SDK 板级配置
 - 4.3 查看编译命令
 - 4.4 自动编译
 - 4.5 各模块编译及打包
 - 4.5.1 U-Boot 编译
 - 4.5.2 Kernel 编译
 - 4.5.3 Recovery 编译
 - 4.5.4 Buildroot 编译
 - 4.5.5 Buildroot 的交叉编译
 - 4.5.5.1 Buildroot 中模块编译
 - 4.5.6 固件的打包
5. 刷机说明
 - 5.1 Windows 刷机说明
 - 5.2 Linux 刷机说明
 - 5.3 系统分区说明
6. RK3326 SDK 固件

1. 开发环境搭建

我们推荐使用 Ubuntu 20.04 的系统进行编译，其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外，还有其他软硬件方面的要求：硬件要求：64 位系统，硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建，将需要更大的硬盘空间。软件要求：Ubuntu 20.04 系统：编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下：

```
sudo apt-get install git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect \
g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib \
g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev libgucharmap-2-90-dev \
bzip2 expat gpgv2 cpp-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu
```

建议使用 Ubuntu 20.04 系统或更高版本开发，若编译遇到报错，可以视报错信息，安装对应的软件包。

2. 软件开发指南

2.1 开发向导

为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作，随 SDK 发布《Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf》，可在 docs 下获取，并会不断完善更新。

2.2 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看，具体方法如下：

```
# Linux4.4 SDK
.repo/manifests$ realpath rk3326_linux_release.xml
# 例如：打印的版本号为 v1.8.0，更新时间为 20220620
<SDK>/.repo/manifests/rk3326_linux_release_v1.8.0_20220620.xml

# Linux4.19 SDK
.repo/manifests$ realpath rk3326_linux4.19_release.xml
# 例如：打印的版本号为 v1.2.0，更新时间为 20220620
<SDK>/.repo/manifests/rk3326_linux4.19_release_v1.2.0_20220620.xml

# Linux5.10 SDK
.repo/manifests$ realpath rk3326_linux5.10_release.xml
# 例如：打印的版本号为 v1.0.0，更新时间为 20220920
<SDK>/.repo/manifests/rk3326_linux5.10_release_v1.0.0_20220920.xml
```

软件发布版本更新内容通过工程文本可以查看，具体方法如下：

```
# Linux4.4 SDK
.repo/manifests$ cat RK3326_Linux_SDK_Release_Note.md

# Linux4.19 SDK
.repo/manifests$ cat RK3326_Linux4.19_SDK_Release_Note.md

# Linux5.10 SDK
.repo/manifests$ cat RK3326_Linux5.10_SDK_Note.md
```

或者参考工程目录：

```
# Linux4.4 SDK
<SDK>/docs/RK3326/RK3326_Linux_SDK_Release_Note.md

# Linux4.19 SDK
<SDK>/docs/RK3326/RK3326_Linux4.19_SDK_Release_Note.md

# Linux5.10 SDK
<SDK>/docs/RK3326/RK3326_Linux5.10_SDK_Note.md
```

3. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考用户使用指南，在工程目录：

RK3326 硬件设计指南：

```
<SDK>/docs/RK3326/Hardware/Rockchip_RK3326_Hardware_Design_Guide_V1.1_CN.pdf
```

RK3326 EVB 硬件开发指南：

```
<SDK>/docs/RK3326/Hardware/Rockchip_RK3326_User_Manual_EVB_V1.0_CN.pdf
```

4. SDK 配置框架说明

4.1 SDK 工程目录介绍

SDK 目录包含有 buildroot、debian、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程，提交需要在各自的目录下进行。

- app：存放上层应用 APP。
- buildroot：基于 Buildroot（2018.02-rc3）开发的根文件系统。
- device/rockchip：存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs：存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- IMAGE：存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。
- external：存放第三方相关仓库，包括音频、视频、网络、recovery 等。
- kernel：存放 Kernel 4.4 开发的代码。

- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。
- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。
- u-boot: 存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。

4.2 SDK 板级配置

进入工程 /device/rockchip/RK3326 目录：

板级配置	说明
BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v10.mk BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v10-32bit.mk	适用于 RK3326 EVB V10 搭配 LP3/LP4 开发板
BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v12.mk BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v12-32bit.mk	适用于 RK3326 EVB V12 搭配 LP3/LP4 开发板
BoardConfig-rk3326-robot64.mk BoardConfig-rk3326-robot64_no_gpu.mk	适用于 RK3326 Robot 小系统开发
BoardConfig.mk	默认配置

方法一：

`./build.sh` 后面加上板级配置文件，例如：

选择 **RK3326 EVB LP3 V10** 的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk3326/BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v10.mk
或
./build.sh device/rockchip/rk3326/BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v10-32bit.mk
```

选择 **RK3326 EVB LP3 V12** 的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk3326/BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v12.mk
或
./build.sh device/rockchip/rk3326/BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v12-32bit.mk
```

选择 **RK3326 Robot** 的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk3326/BoardConfig-rk3326-robot64.mk
或
./build.sh device/rockchip/rk3326/BoardConfig-rk3326-robot64_no_gpu.mk
```

方法二：

```
rk3326$ ./build.sh lunch
processing option: lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:
```

```

0. default BoardConfig.mk
1. BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v10-32bit.mk
2. BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v10.mk
3. BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v12-32bit.mk
4. BoardConfig-rk3326-evb-lp3-v12.mk
5. BoardConfig-rk3326-robot64.mk
6. BoardConfig-rk3326-robot64_no_gpu.mk
7. BoardConfig.mk
Which would you like? [0]:
...

```

4.3 查看编译命令

在根目录执行命令: `./build.sh -h|help`

```

rk3326$ ./build.sh -h
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
BoardConfig*.mk    -switch to specified board config
lunch               -list current SDK boards and switch to specified board config
wifibt              -build wifibt
uboot               -build uboot
uefi                -build uefi
spl                 -build spl
loader              -build loader
kernel              -build kernel
modules             -build kernel modules
toolchain           -build toolchain
rootfs              -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot           -build buildroot rootfs
ramboot             -build ramboot image
multi-npu_boot      -build boot image for multi-npu board
yocto               -build yocto rootfs
debian              -build debian rootfs
pcba                -build pcba
recovery            -build recovery
all                 -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
cleanall            -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
firmware            -pack all the image we need to boot up system
updateimg           -pack update image
otapackage          -pack ab update otapackage image (update_ota.img)
sdpackage           -pack update sdcard package image (update_sdcard.img)
save                -save images, patches, commands used to debug
allsave             -build all & firmware & updateimg & save
check               -check the environment of building
info                -see the current board building information
app/<pkg>            -build packages in the dir of app/*
external/<pkg>       -build packages in the dir of external/*

createkeys          -create secureboot root keys
security_rootfs     -build rootfs and some relevant images with security paramter
(just for dm-v)
security_boot       -build boot with security paramter
security_uboot      -build uboot with security paramter
security_recovery   -build recovery with security paramter

```

```
security_check      -check security paramter if it's good
```

Default option is 'allsave'.

查看部分模块详细编译命令，例如： `./build.sh -h kernel`

```
rk3326$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm64 px30_linux_defconfig rk3326_linux.config
make ARCH=arm64 rk3326-evb-lp3-v10-linux.img -j12
```

4.4 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译：

```
./build.sh all # 只编译模块代码（u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery）
               # 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh     # 在./build.sh all基础上
               # 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
               # 2. update.img打包
               # 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
               # 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
               # 注：./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样
```

4.5 各模块编译及打包

4.5.1 U-Boot 编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

4.5.2 Kernel 编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```


4.5.3 Recovery 编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注：Recovery是非必需的功能，有些板级配置不会设置。

4.5.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包：

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip_rk3326_64/images下生成 rootfs.ext4。

4.5.5 Buildroot 的交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用，需对交叉编译环境进行配置。比如 RK3326，其交叉编译工具位于 buildroot/output/rockchip_rk3326_64/host/usr 目录下，需要将工具的 bin/ 目录和 aarch64-buildroot-linux-gnu/bin/ 目录设为环境变量，在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本：

```
source envsetup.sh
```

输入命令查看：

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3326_64/host/usr/bin
./aarch64-linux-gcc --version
```

此时会打印如下信息：

```
aarch64-linux-gcc.br_real (Buildroot 2018.02-rc3-XXXXXX) 10.3.0
# XXXXXX 为 Buildroot 最新 commit ID
```

4.5.5.1 Buildroot 中模块编译

比如编译 busybox 模块，常用相关编译命令如下：

- 编译 busybox

```
SDK$ make busybox
```

- 重编 busybox

```
SDK$ make busybox-rebuild
```

- 删除 busybox

```
SDK$ make busybox-dirclean  
或者  
SDK$ rm -rf buildroot/output/rockchip_rk3326_64/build/busybox-1.34.1
```

4.5.6 固件的打包

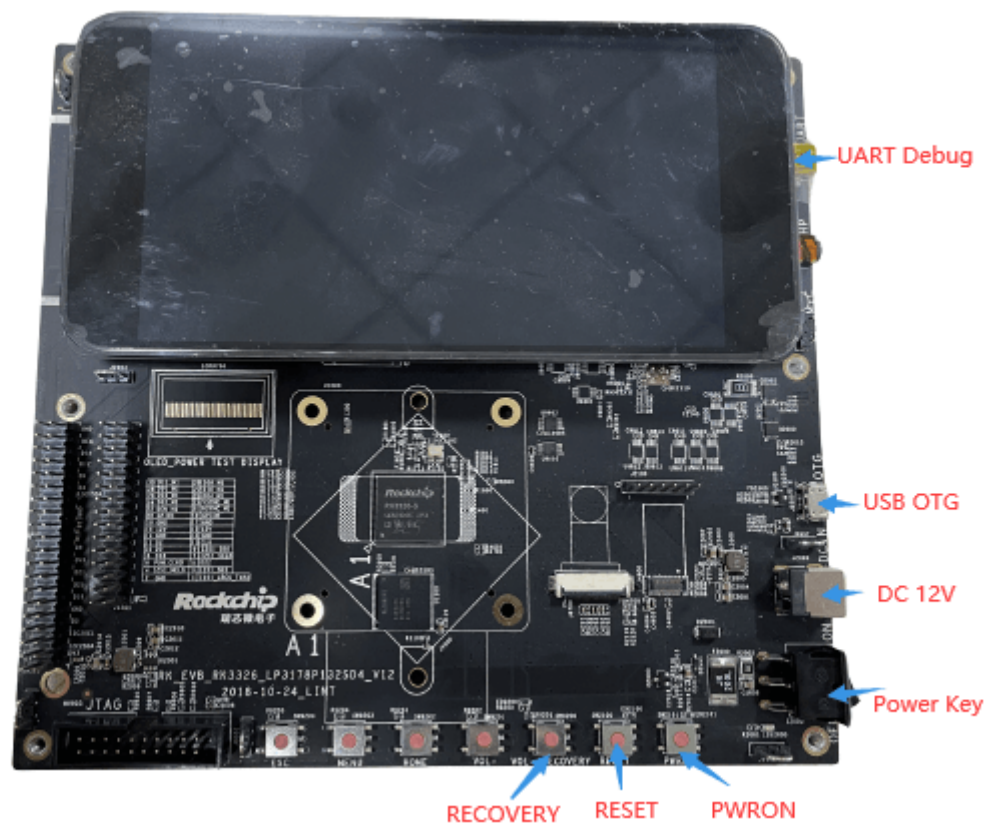
上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后，进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下：

固件生成：

```
./mkfirmware.sh
```

5. 刷机说明

RK3326-EVB 接口分布图如下：

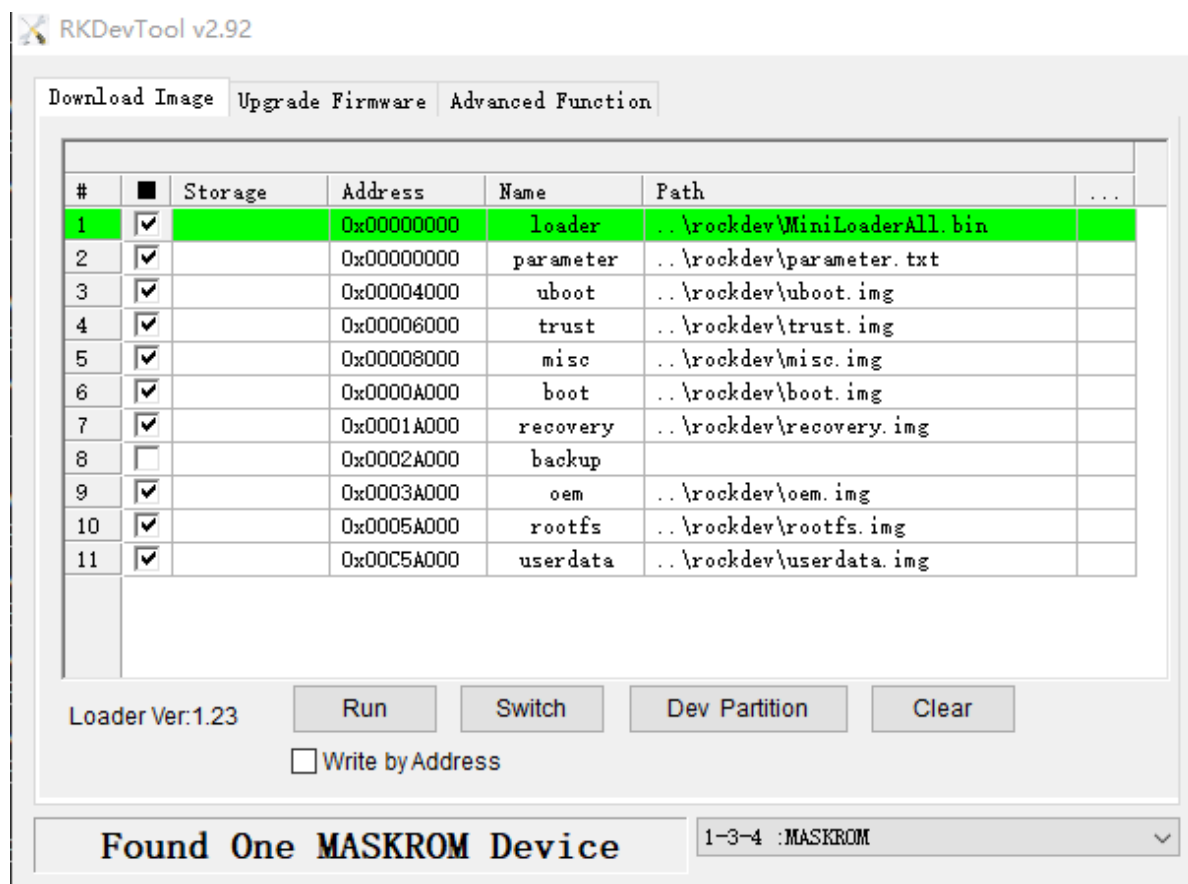


5.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.92 或以上)，工具位于工程根目录：

```
tools/
└─ windows/RKDevTool
```

如下图，编译生成相应的固件后，设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式，连接好 USB 下载线后，按住按键 "MASKROM" 不放并按下复位键 "RST" 后松手，就能进入 MASKROM 模式，加载编译生成固件的相应路径后，点击 "执行" 进行烧写，也可以按 "recovery" 按键不放并按下复位键 "RST" 后松手进入 loader 模式进行烧写，下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。(注意：Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注：烧写前，需安装最新 USB 驱动，驱动详见：

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.12.zip
```

5.2 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V2.1 或以上)，请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下，升级命令如下：

```
sudo ./upgrade_tool ul -noreset rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -t rockdev/trust.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rockdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级打包后的完整固件：

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录，机器在 MASKROM 状态运行如下升级：

```
./rkflash.sh
```

5.3 系统分区说明

默认分区说明（下面是 RK3326 EVB 分区参考）

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Name
1	16384	24575	4096K	uboot
2	24576	32767	4096K	trust
3	32768	40959	4096K	misc
4	40960	106495	32M	boot
5	106496	303104	32M	recovery
6	172032	237567	32M	bakcup
7	237568	368639	64M	oem
8	368640	12951551	6144M	rootfs
9	12951552	30535646	8585M	userdata

- uboot 分区：供 uboot 编译出来的 uboot.img。
- trust 分区：供 uboot 编译出来的 trust.img。
- misc 分区：供 misc.img，给 recovery 使用。
- boot 分区：供 kernel 编译出来的 boot.img。
- recovery 分区：供 recovery 编译出的 recovery.img。
- backup 分区：预留，暂时没有用，后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。
- oem 分区：给厂家使用，存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。
- rootfs 分区：供 buildroot 编出来的 rootfs.img。
- userdata 分区：供 APP 临时生成文件或给最终用户使用，挂载在 /userdata 目录下。

6. RK3326 SDK 固件

- 百度云网盘

[Buildroot](#)

- 微软 OneDriver

[Buildroot](#)